证券代码：301041　　证券简称：金百泽　　公告编号：2024-020

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金百泽	股票代码	301041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈鹏飞		
办公地址	深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼		
传真	0755-2673 3968		
电话	0755-2652 5959		
电子信箱	investor@kingbrother.com		

2、报告期主要业务或产品简介

金百泽成立于 1997 年，公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，通过集成与设计制造 IDM 为客户的产品研发和硬件创新提供垂直整合的一站式解决方案。同步打造科创服务、数字化平台服务等多项业务，致力于打造世界级电子产品研发和硬件创新服务平台。

报告期内，公司的主要业务未发生重大变化，公司的主要业务可分为集成与设计制造 IDM 下的电子设计服务、印制电路板 PCB、电子制造服务 EMS 以及科创服务、数字化平台服务等。

公司服务的代表行业和产品的代表应用如下图所示：

1、集成设计与制造 IDM

（1）IDH 方案设计

公司坚持以"设计先行，协同创新"的经营策略，为客户提供电子产品模块、底板、核心板、整版个性化定制搭配等垂直整合解决方案，致力于成为特色的电子产品研发和硬件创新集成服务商。基于让创新更简单的服务理念，公司重点推出电力、物联网、汽车电子、医疗电子、新能源等细分行业的基于 IDM 的硬件智能控制模组方案，赋能战略大客户的"集成创新"；

公司设立省级特种电子电路工程中心、电子工程实验室，提升 KB EDA/DFX 及可制造性设计能力，利用 DFX 系统构建元器件 3D 建模，完成 DFA 可装配性仿真，提前模拟 PCBA 试装配，提前发现和设计 DFX 的相关障碍，做到质量预防（优化设计和工艺补偿），保障产品的可靠性质量的落地。

（2）PCB 设计

电路板设计 Layout：主要为客户提供高速、高密、高可靠性的 PCB 设计。资深团队，独有的专业工具，从功能设计到工程设计，为产品构魂。基于公司长期服务 10000 多家客户的产品研发和 PCB 设计经验积累，形成了丰富的可制造性设计 DFM 数据库，通过开展电子设计服务，满足客户加快研发创新速度和减少设计变更频率的需求。

公司在北京、深圳、惠州、西安、成都、武汉、长沙等重点城市设立了多个 PCB 设计部，由经验丰富的工程师组成设计团队，服务于全球创新型客户。

自主开发的 EDA 辅助工具 KBEDA-Skill，适用于主流 PCB LAYOUT 软件，让 PCB 设计更简单。拥有 400 多个不同应用功能，其中多项功能获得软件著作权和专利授权。该软件工具为工程师提升设计品质和设计效率，帮助客户缩短周期。另外，自主开发的 KBEDA-DFM，基于设计源文件的评审，更加直接、高效，包括可制造性的审核、设计规范性的审核，可在线检测并分享和修改异常。

金百泽电子封装库，是基于二十余年技术沉淀，资源库已达到 10 万+种不同类型的元器件。KBEDA-LIB 打造了电子设计资源封装库管理系统，实现标准规范 EDA 库的统一管理和维护，并建立库流程管理机制，实现了自动化、智能化、标准化的 EDA 库平台。

（3）PCB 样板和中小批量研发生产

印制电路板 PCB 是电子产品的核心电子互连件，起到为各类电子元器件提供机械支撑、电气连接和信号传输的作用。印制电路板几乎存在于所有的电子设备中，电子产品的可靠性和稳定性很大程度上依赖于印制电路板的制造品质，因此印制电路板被称作"电子产品之母"。公司的 PCB 业务聚焦电子产品研发阶段的 PCB 样板和中小批量板需求。

公司拥有惠州大亚湾和西安两大印制电路板生产基地，通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001、GJB9001CCQC、AEO、UL、REACH 等质量管理体系及环境管理体系认证；拥有高精密先进自动化设备，具有实现数据化、可视化、高可靠性产品的交付能力。产品类型覆盖高多层电路板、HDI 板、刚挠结合板、高频板、金属基板、厚铜电路、嵌入式印制电路板等；产品应用领域覆盖智慧城市、信息技术、工业控制、汽车电子、医疗设备、电力系统、新能源、军工、消费电子、人工智能、无人机及科研院校等众多领域；具有多品种、小批量、短交期、相对高毛利的特点。

公司以 PCB 样板为入口，顺应各行业电子化升级和个性化需求趋势，发展中小批量 PCB 板，满足越来越多的客户对 PCB 样板和 PCB 中小批量一站式采购的需求，有效突破样板市场的规模限制。

（4）EMS 特色创新电子制造服务

电子制造服务致力于为客户提供垂直整合的一站式解决方案。据统计报导，EMS 市场规模是 PCB 市场的 7-10 倍，具有广阔的发展空间和应用范围。PCB 作为电子产品之母，EMS 电子制造服务与其具有客户同源、技术同根、产品沿袭的特点。PCB 与 EMS 一站式服务简化了客户的供应链管理和技术服务的外包流程，增加了客户的粘性和技术的围堰，多品种、小批量、PCB 与 EMS 全流程服务已成为客户对供应链的策略性需求，具有广阔的市场前景。

公司的 EMS 特色电子制造服务专注于电子产品研发和工程服务需求，为客户提供包括 PCBA 电子装联服务、BOM 齐套方案服务、元器件检测与可靠性服务，通过可制造性设计 DFM 和可装配性设计 DFA 约束规则、可采购性设计 DFP 工程数据，提供产品的可制造性和产品的可靠性保障，为客户提供精准的定制化服务。

2、科创服务

27 年来，公司始终专注于电子电路集成电子产品设计与硬件创新服务，为客户提供包含硬件设计、软件设计、工业设计、BOM 技术等高质、高可靠性的硬件产品创新、设计和制造服务一站式硬件产品创新解决方案。

科创服务，是公司将多年的技术积累和产业实践积累回馈、助力电子信息产业发展的综合业务。公司根据时代需求，不断加强科创业务拓展。基于 27 年的科创实践，公司以技术服务、智造服务、产业服务为核心，进而延伸至人才培育与人力资源服务、工业资本服务和科技成果转化服务，从技术、供应链、产业，到核心技术人才、工业资本和成果转化，最大限度降低科技企业、创新创业团队、高校、科研机构和创业者的技术难题、供应链难题、产品中试与制造难题、核心技术人才难题、融资难题等创新创业障碍，大大降低创新创业的资金投入和产品研发风险，加速产品落地速度，有效提升产品质量，为创新产品的落地保驾护航，真正实现为创新型科技产品从设计、研发、中试、检测到量产的一站式技术型科创加速服务，助力了电子电路产业创新企业的壮大与发展，进而促进了公司业务的持续发展。

3、数字化平台服务

通过持续的技术投入和产业实践，积累了丰富的工业互联网和工业数字化转型经验，构筑了自主可控的数字化业务中台和敏捷的集成供应链交付体系，从而打通了从研发、设计、制造到采购等产业链上下游资源，构建了新型的数字化供应链云平台。

公司基于行业理解与数字化实践经验，联合数字化生态合作伙伴，提供全套行业中小制造企业数字化转型解决方案赋能，助力行业工业软件国产化发展，打造了造物数科数字化中试平台建设服务能力。通过造物应龙智慧云工厂平台，链接集成客户硬件产品创新云服务，通过自主可控的数字化业务中台和集成供应链交付能力，构建柔性精益的营销协同、设计协同、生产协同与供应协同体系，加速客户硬件产品的创新。聚合从研发、设计、制造、采购到物流等领域的合作商，建立新型的数字化供应链平台，通过数字化技术实现产业链上下游、产业集群的业务一体化融合，为产业创造价值，为客户提供优质的产品与服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	906,741,791.86	835,555,825.93	8.52%	869,367,888.90
归属于上市公司股东的净资产	668,099,558.77	633,582,490.64	5.45%	607,495,728.67
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	635,698,072.24	651,657,182.91	-2.45%	699,431,896.24
归属于上市公司股东的净利润	39,637,708.13	33,874,401.97	17.01%	51,403,257.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,146,861.38	24,312,181.35	28.11%	38,769,388.25
经营活动产生的现金流量净额	104,607,486.87	27,461,204.11	280.93%	49,047,187.73
基本每股收益（元/股）	0.37	0.32	15.63%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.32	15.63%	0.58
加权平均净资产收益率	6.09%	5.46%	0.63%	10.70%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	148,729,396.69	160,351,657.25	156,817,130.93	169,799,887.37
归属于上市公司股东的净利润	3,981,293.51	14,794,036.64	8,227,596.16	12,634,781.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,099,463.69	12,970,856.90	6,244,597.13	8,831,943.66
经营活动产生的现金流量净额	12,817,562.78	36,957,720.34	7,990,705.99	46,841,497.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,027	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,492	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
武守坤	境内自然人	34.47%	36,776,232	36,776,232	不适用	0
张伟	境内自然人	8.66%	9,242,000	0	不适用	0
武守永	境内自然人	7.64%	8,148,000	8,148,000	不适用	0
深圳光影资本管理有限公司-光影丰赟 5 号私募证券投资基金	其他	0.69%	735,800	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.58%	613,957	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.55%	581,4690	0	不适用	0
陈家夫	境内自然人	0.54%	572,604	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.49%	525,838	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.47%	503,502	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.44%	470,739	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	武守坤与武守永为同胞兄弟关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 ☐不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	退出	0	0.00%	150,019	0.14%
深圳市花梦资本管理有限公司-花梦 33 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利 5 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳市同晟金泉投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳市凯硕投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
周岳豪	退出	0	0.00%	95,000	0.09%
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳光影资本管理有限公司-光影丰赟 5 号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	735,800	0.69%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	613,957	0.58%
BARCLAYS BANK PLC	新增	0	0.00%	581,469	0.55%
陈家夫	新增	0	0.00%	572,604	0.54%
UBS AG	新增	0	0.00%	525,838	0.49%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	503,502	0.47%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	470,739	0.44%

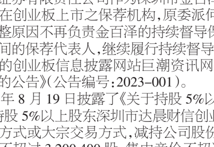
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、爱建证券有限责任公司作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，原委派何俣先生、曾辉先生担任持续督导保荐代表人，因何俣先生工作调整原因不再负责金百泽的持续督导保荐工作，授权丁冬梅女士接替何俣先生担任金百泽持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-001）。

2、2022 年 8 月 19 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（以下简称"预披露公告"），公司持股 5%以上股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司（以下简称"达晨财信"）拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式，减持公司股份不超过 3,200,400 股，即不超过公司总股本的 3%（其中大宗交易不超过 3,200,400 股，集中竞价不超过 2,133,600 股）；预披露公告之日起至 2023 年 3 月 9 日，达晨财信通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司股份合计 3,039,292 股，占公司总股本的 2.8490%，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于特定股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2023-005）。

3、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的议案》，新增公司及其全资子公司造物云为"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"的实施主体，同时增加造物云募集资金专户。2023 年 5 月 19 日，公司及全资子公司造物云与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构爱建证券有限责任公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-017）及《关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-025）。

4、2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本 106,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.48 元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币 5,120,640.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

5、公司与天府科创投拟结合各自优势资源共建"星创惠泽基金"，并探索聚焦"基金投资+服务赋能"协同发展的模式。公司将与天府科创投共同围绕星创惠泽基金的运营与管理，细化和完善合作模式，并签署了《共同设立"四川天府新区星创惠泽基金"战略意向合作协议》。2023 年 10 月 10 日，公司与四川天府新区天沃投资有限责任公司、四川天府新区天升坤祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川天府新区星盈企业管理合伙企业（有限合伙）共同签署了《四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司认缴出资额 2,000 万元，出资比例 19.46%。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日、2023 年 10 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构签署战略意向合作协议的公告》（公告编号：2023-029）、《关于签署四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议的公告》（公告编号：2023-040）。

6、公司与全资子公司深圳市金百泽科技有限公司（以下简称"金百泽科技"）拟与其他机构共同投资海南百彦二期半导体产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南百彦"或"合伙企业"）。其中，公司作为海南百彦的有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资 990 万元；金百泽科技为海南百彦的普通合伙人之一，使用自有资金认缴出资 10 万元，本次投资完成后公司和金百泽科技将合计持有海南百彦 25%的合伙份额。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-048）。

7、公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并由公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 13 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-046）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-049）。

8、公司董事会同意公司参加知识产权资产证券化项目，将公司及子公司名下有权处分的四项专利权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称"高新投小额贷款"），向高新投小额贷款申请最高额度不超过人民币 4,000 万元、期限为一年期的综合授信；并委托深圳市高新投融资担保有限公司为公司上述授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参加知识产权资产证券化项目及融资的公告》（公告编号：2023-045）。

证券代码：300077　　证券简称：国民技术　　公告编号：2024-010

国民技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国民技术	股票代码	300077
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶艳桃	欧弘妍	
办公地址	深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 21 层	深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 21 层	
传真	0755-86916692	0755-86916692	
电话	0755-86916692	0755-86916692	
电子信箱	investors@nationstech.com	investors@nationstech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务涵盖集成电路领域及新能源负极材料两个领域。

（一）集成电路领域

1、公司所处细分行业及主要业务

公司是集成电路设计企业，主要从事自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务。

2、经营模式

公司采用常规和灵活的 Fabless 轻资产经营模式，从事集成电路产品的研发设计和销售，将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆制造及封装测试厂商。该经营模式有利于公司集中优势资源用于集成电路产品研发与设计环节，在完成集成电路全流程的设计工作后，将自有产权的集成电路版图授权晶圆制造厂商进行生产制造，由晶圆制造厂商按照版图数据生产出晶圆后，再交由封装、测试厂商完成封装、测试环节。公司取得集成电路芯片成品后，启动对外销售，部分芯片产品应市场需求，委托外协厂商加工成多芯片模组（SIP），对外销售。根据行业、产品及市场需求情况，公司采取直销和渠道销售相结合的销售推广模式，开展公司的主要业务经营。

3、主要产品

公司持续聚焦"通用+安全"产品及市场战略，围绕 SoC、信息安全、电源管理、射频四大核心领域，创新研发通用 MCU、安全芯片、无线射频、BMS 等技术与产品，打造了通用 MCU、高等级安全芯片、BMS 芯片、蓝牙无线射频芯片等四大产品阵列。现有产品涉及通用 MCU、金融安全、物联网安全、可信计算、BMS、超低功耗蓝牙等芯片产品。未来将持续升级、扩展通用 MCU 产品、并推出系列化 BMS 芯片产品，形成多个业务领域协同发展效应，构筑行业综合竞争能力。

4、下游应用领域及应用示例

（1）通用 MCU 产品线，主要覆盖电池及能源管理、汽车电子、智能家电及智能家庭物联网终端、工业联网及工业控制、电机驱动、伺服、机器自动化、物联网、智能表计、安防、通讯、传感器、消费电子、医疗电子、生物识别等应用领域和方向。典型应用覆盖电池 BMS、储能、逆变器、数字电源及 UPS、充电桩、换电柜、车用电子、冰箱、空调、洗衣机、扫地机、吸尘器、智能门锁、工业伺服、PLC、电机驱动控制器、电动两轮车、滑板车、平衡车、飞控云台、3D 打印、微型打印机、水表及燃气表、手持云台、TWS 耳机、健康智能硬件及医疗设备、血氧仪、血糖仪等。

（2）安全芯片产品线，主要应用于网络身份认证、电子银行、可信计算、电子证照、移动支付与服务器/云安全、物联网安全等信息安全领域。

（3）射频芯片产品线，主要应用于物联网、可穿戴设备、智能家居等。

（4）BMS 产品线，报告期内公司面向消费领域 BMS 产品已完成投片并进入客户验证阶段，主要应用于笔记本、平板电脑、手机、无人机等电池包的应用，并将持续发展高可靠性汽车电子、工业储能电源管理 BMS 器件及解决方案。

5、下一报告期内下游应用领域的宏观需求分析

短期来看，2022 年以来，全球半导体行业增速明显放缓，开始进入下行周期。展望 2024 年，在 AI 应用的刺激带动下，全球半导体行业有望呈现"整体稳步恢复，细分领域结构性分化调整"的态势。根据 Gartner、IDC、WSTS 等全球市场机构预测的数据，2024 年全球半导体产业增速将超过两位数，平均预测增速在 13%-15%左右，规模超过 6000 亿美元，增长预计将主要由人工智能、存储芯片行业推动。尽管总体上进入复苏周期，市场需求仍然不强劲，整体增长动力有限，部分细分领域仍面临较大挑战。长期来看，随着人工智能、云计算、新能源汽车、工业自动化、物联网等新兴产业的发展，半导体需求量依然较为强劲。

6、公司所处行业市场竞争格局情况

我国集成电路产业起步较晚，国际厂商凭借多年在资金、技术、客户资源、品牌、应用生态等方面的积累，形成了明显的领先优势。总体而言，目前我国集成电路设计、晶圆制造的整体水平与国际先进水平尚有较大差距。集成电路设计领域，国际厂商在中高端芯片市场占据主导地位，国内厂商在集成电路市场长期处于中低端领域。

在 MCU 领域，从全球市场来看，主要供应商仍然以国际厂商为主，行业集中度较高，恩智浦、微芯、瑞萨、意法半导体、英飞凌、德州仪器等厂商占据主导地位，行业垄断企业集中效应显著，国内厂商市场占有率不高且长期处于中低端产品市场。根据 Yole 统计的数据，2022 年全球 MCU 市场中前五大厂商控制了 81%的市场份额，如果计算前六，则占有率则高达 87%，且均为国际厂商。相对于全球 MCU 市场而言，国内 MCU 市场较为分散、竞争者数量较多，且主要市场份额仍被国际厂商所占据，同时国际厂商得益于多年的技术积累，中高端产品系列较多和全。尽管如此，近几年国内 MCU 厂商在产品性能、集成度、稳定性、配套开发生态等各方面已取得较好发展，在消费电子等中低端市场已经具备较强竞争力，国内 MCU 厂商也由原先以消费电子为主，积极加强向高壁垒、高毛利的工业控制、汽车电子等中高端领域布局拓展，并且已取得了一定的成绩。总体来说，虽然国内 MCU 企业在国内市场占据的市场份额较低，但随着国内 MCU 厂商的设计能力不断提升，产品系列陆续日趋完善以及终端客户对于供应链自主可控需求的不断增长，国内 MCU 厂商未来市场发展空间仍然巨大。

在信息安全领域，公司持续深耕信息安全市场和技术领域，作为我国最早的商用密码核心定点单位，以具有特定优势的芯片级安全技术、低功耗及无线射频等长期积累的丰厚技术优势，构筑产品及业务综合市场竞争力优势。公司目前为国内 USBKEY 芯片、蓝牙 KEY 芯片、可信计算芯片的主要供货商之一，保持较高的市场占有率。

7、发展战略及经营计划

公司将继续拓展实施"通用+安全"产品战略，聚焦核心市场和应用做精做深做广，持续丰富产品组合，重点在高端高性能 MCU、高可靠性 BMS、安全芯片等战略产品线上投入资源。通过不断提升产品技术性能指标和产品质量，增强产品功能属性和安全标准，持续提升公司在传统安全领域以及在通用领域产品市场竞争力。同时，公司将通过不断完善产品系列和持续服务，深入应用场景打磨解决方案，并充分利用公司通用 MCU 产品高集成度、高性能、低功耗、高性价比、安全性等差异化优势，提高 MCU 市场竞争力，努力在通用 MCU 领域将公司打造成为集技术优势、产品种类的丰富性、交付质量稳定性为一体的国内领军企业。

（1）继续拓展实施"通用+安全"战略，保持和提升产品及业务核心竞争力

公司具备传统信息安全领域的技术及产品优势，在保持该领域技术与业务核心优势同时，积极拓展多元化的市场应用空间，针对新兴市场对信息安全的应用需求情况，进一步拓展相关产品和解决方案。与此同时，公司以具有特定优势的安全密码算法性能、低功耗、SoC 架构与 IP 经验积累和技术沉淀优势，积极布局通用 MCU 领域产品和应用，增强产品安全性能和通用性能，形成差异化和优势产品系列，充分利用公司拥有的供应链资源优势降低成本，积极把握"万物互联"的市场机遇，拓展在工业控制、智能家电及智能家庭物联网终端、智能表计、安防、医疗电子、电机驱动、电池及能源管理、生物识别、通讯、传感器、机器自动化等行业应用。同时，不断探索在战略性新兴产业中涌现出的行业市场机会，以及在新一代信息技术产业中，各领域资源整合和合作带来的新市场和新业务。

（2）专注研发投入，升级产品档次，优化产品结构，提升核心竞争优势

针对通用 MCU 领域，公司将扩大 32 位 MCU 产品研发技术路径，做精做深做广，落实更高性能技术路径；在高端高性能 MCU、高可靠性 BMS 等战略产品线上投入资源；在保持通用 MCU 领域安全性核心技术竞争力基础上，提升产品在高集成度、高性能、低功耗、高可靠性等技术优势。公司将继续进行通用 MCU 芯片技术的研发，通过技术研发提升产品性能、加快生态体系建设，构建通用 MCU 核心竞争力。公司将持续完善通用 MCU 芯片产品系列化及其解决方案，根据行业不同应用领域和行业发展趋势，持续研发、推出高集成度、高性能、高可靠性、具有安全属性和低功耗等技术特色的通用 MCU 产品，为客户和市场提供更多产品选择。

针对信息安全业务，公司将继续专注于集成电路行业与信息安全交叉领域，持续增强安全技术升级，持续优化及迭代和发展安全芯片、低功耗蓝牙等传统优势产品；继续达成推进可信计算芯片的 CC 认证，扩大互联网、物联网的应用解决方案范围，保持与增强该领域产品核心竞争力。

（3）加强市场拓展，扩大市场份额

公司以行业市场和通用市场并举，深入耕耘行业市场，紧跟通用市场发展趋势，研发更具竞争力、更符合客户需求的产品和解决方案，推动公司各类芯片在细分市场的领先性。同时，公司将在发展国内市场的同时，加大对国际市场业务的布局力度，积极开拓国际市场，提高市场份额。

通用 MCU 领域：利用公司在 SoC 芯片的技术积累和沉淀优势，发挥在 MCU 领域高集成度、低功耗、高可靠性等优势，增强 MCU 安全性，提供具有差异化和全系列化的产品和解决方案特色优势，通过持续丰富产品系列和细分方向的应用，抓住国产供应链建立的机遇，加强在工业控制、电池及能源管理、智能家庭物联网终端、智能表计、安防、医疗电子、电机驱动、生物识别、通讯、传感器、机器自动化等行业市场的进入。在部分行业突破国外企业垄断，占据更多市场份额，努力将公司打造为在技术、产品种和量产交付数量上的国内领军企业。

信息安全领域：在巩固现有行业市场应用竞争力的同时，以针对性更强、应用更灵活的产品及系统解决方案，将各类产品及解决方案进一步进入物联网、工业互联网、微认证应用等安全领域市场，促进物联网市场应用的数据保护及物联网身份认证的安全性，加强和行业主流厂商的深入合作；推动可信计算芯片在互联网、大数据、云计算、物联网等安全领域的发展。

（4）加强核心技术人才的引进和培养

公司拥有集成电路行业和新能源负极材料行业中优秀而多元化的团队，他们在产品、技术、研发、供应链、销售和管理上均具有多年从业经历。优秀的人才队伍是公司赖以生存与发展的核心竞争力，为公司未来可持续性发展提供有力的保障。公司将持续加大对外引进人才、对内培养人才梯队的力度，建立健全企业文化，设立有效激励制度，优胜劣汰保持团队活力，优化人力资源结构，不断提升组织能力和公司价值。

（二）新能源负极材料领域

1、报告期内主要业务及产品

目前，新能源负极材料领域业务由控股子公司内蒙古斯诺承担，其主要从事锂离子电池负极材料研发、生产和销售，以及石墨化加工服务。负极材料主要应用于新能源汽车动力电池、3C 数码和储能等锂电池领域；石墨化加工工艺是锂离子电池负极材料生产过程中的核心工艺环节之一。报告期内石墨化加工除满足内部需求外，也为行业其他用户提供部分石墨化加工服务。

2、经营模式

（1）采购模式。内蒙古斯诺采购的原材料主料为焦类产品、石墨，辅料为沥青，为保障原材料的稳定供应，同时降低采购成本，采用"按需采购"的模式。

（2）生产模式。内蒙古斯诺实行"自主生产"模式，结合各类型产品的销售情况、原材料和半成品、成品库存量，制定生产计划。石墨化加工主要配套自身负极材料石墨化加工需求，在满足自身需求的基础上剩余产能可对外提供加工服务。

（3）销售模式。内蒙古斯诺以直销为主，通过多种渠道积极响应行业内客户需求，加快自身技术和产品的升级速度。

3、报告期内行业竞争情况及趋势

全球锂电池负极材料生产企业主要分布于中国，其余主要为日本、韩国等国家。国内负极材料的主要供应商有贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、中科星城、东莞凯金、尚太科技、翔丰华等，国外负极材料的主要供应商有日立化成、浦项化学及三菱化学等。根据 EVTank 统计，2023 年贝特瑞、杉杉股份、璞泰来继续保持负极材料出货量行业前三名，三家企业合计市场份额达到 48.63%，行业前十企业的门槛出货量从 2022 年的 1.9 万吨提高到 2023 年的 4.0 万吨。

由于下游市场需求增速放缓，叠加负极行业企业扩建产能进入释放期，负极材料行业面临的产能消纳和价格下行的压力持续加大。从短期来看，整个行业将面临着较大的产能过剩压力，负极材料的价格仍将面临着压力，市场竞争进一步加剧。随着负极材料产业竞争的加剧，低端低效率重复产能将被淘汰，拥有核心技术、较强的质量控制能力、极致成本控制能力和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,802,581,431.86	3,706,260,780.79	3,713,733,332.22	2.39%	2,667,945,584.97	2,675,706,023.10
归属于上市公司股东的净资产	1,171,135,614.15	1,649,104,378.38	1,649,104,378.38	-28.98%	1,542,705,141.21	1,542,705,141.21
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,036,752,756.19	1,195,410,943.37	1,195,410,943.37	-13.27%	1,017,608,714.04	1,017,608,714.04
归属于上市公司股东的净利润	-571,523,582.15	-32,485,009.01	-32,485,009.01	-1,659.35%	218,975,957.10	218,975,957.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-500,677,155.87	-115,814,093.18	-115,814,093.18	-332.31%	46,358,016.73	46,358,016.73
经营活动产生的现金流量净额	-122,356,616.02	-574,974,400.45	-574,974,400.45	78.72%	212,489,791.79	212,489,791.79
基本每股收益（元/股）	-1.00	-0.06	-0.06	-1,566.67%	0.39	0.39
稀释每股收益（元/股）	-0.99	-0.06	-0.06	-1,550.00%	0.39	0.39
加权平均净资产收益率	-41.99%	-1.71%	-1.71%	-40.28%	16.28%	16.28%

追溯调整或重述原因

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号三个事项的会计处理中，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始施行，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	216,549,275.18	248,773,406.95	294,757,798.59	276,672,275.47
归属于上市公司股东的净利润	-84,214,948.36	-144,004,915.59	-123,095,066.49	-220,208,651.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,526,832.02	-124,120,208.86	-78,534,714.86	-192,495,400.13
经营活动产生的现金流量净额	-162,421,008.75	-97,477,783.89	-68,674,292.24	206,216,468.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,125	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,500	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙迎彤	境内自然人	3.74%	22,244,400.00	16,683,300.00	不适用	0.00
王薇	境内自然人	2.24%	13,314,000.00	0.00	不适用	0.00
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.70%	10,098,702.00	0.00	不适用	0.00
刘益谦	境内自然人	1.51%	8,992,800.00	0.00	不适用	0.00
深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享 11 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	7,485,700.00	0.00	不适用	0.00
余运波	境内自然人	0.89%	5,280,000.00	0.00	不适用	0.00
李锦标	境内自然人	0.76%	4,540,426.00	0.00	不适用	0.00
交通银行股份有限公司-博时半导体主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	3,255,300.00	0.00	不适用	0.00
蔡毛泉	境内自然人	0.52%	3,096,700.00	0.00	不适用	0.00
李标彬	境内自然人	0.48%	2,840,422.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘益谦、王薇为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 ☐不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	5,703,327	0.96%	1,709,400	0.28%	10,098,702	1.70%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

√适用 ☐不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
深圳前海博普资产管理有限公司-博普资产尊享 11 号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
黄学良	退出	0	0.00%	0	0.00%
魏春木	退出	0	0.00%	0	0.00%
王希阳	退出	0	0.00%	0	0.00%
交通银行股份有限公司-博时半导体主题混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
李锦标	新增	0	0.00%	0	0.00%
蔡毛泉	新增	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

☐ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

控股股东性质：无控股股东

控股股东类型：不适用

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权分散，无控股股东、实际控制人：截止本报告期末，孙迎彤先生持有公司 22,244,400 股股份，占公司股本总额的 3.74%，为公司第一大股东。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司虽然销售数量同比有较大幅度增加，但实现营业收入 103,675.28 万元，仍较上年同期下降 13.27%，其中集成电路和关键元器件业务销售量较上期增加近 40%，但因产品价格下滑幅度较大，实现营业收入 46,512.78 万元，同比下降 14.00%；负极材料类（含石墨化加工）实现营业收入 57,162.50 万元，受产品价格下滑影响，同比下降 12.67%，其中负极材料业务（不含石墨化加工）销售数量较上期增加约 40%；实现归属于上市公司股东的净利润-57,152.36 万元，较上年同期下降 1,659.35%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-50,067.72 万元，较上年同期下降 332.31%。

业绩变动的主要原因系：①由于受到行业周期波动等多重因素影响，终端市场需求依然低迷，集成电路行业面临的价格调整、库存去化和市场竞争压力仍在持续上升，报告期内公司集成电路产品毛利较上年同期减少 12,090.28 万元。②负极材料行业前期大规模新建产能逐步释放，供需状况发生变化，产能开始呈现结构性过剩状态，同时负极材料头部厂商石墨化加工自供比例不断提升，对负极材料价格造成冲击，报告期内公司负极材料产品毛利较上年同期减少 18,321.02 万元。③公司为持续增强核心竞争力，丰富产品线，加快新产品布局，仍保持较高的研发投入。④投资收益和公允价值变动损益较上年同期减少 16,349.74 万元，主要是受资本市场价格大幅下滑及写字楼租赁市场不景气影响，公司持有的交易性金融资产与投资性房地产确认了大额的公允价值变动损失。⑤公司对各类资产进行减值测试，计提大额的存货跌价准备、开发支出减值、无形资产减值及商誉减值，资产减值损失较上年增加 14,763.51 万元。